

### Kupfer DIN 1787

Güte	Wst-Nr.	Dichte ca.	Legierungsbestandteile	Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung
E-Cu 57 (E-Cu)	2.0060	8,9	Cu ≥ 99,90 % Sauerstoff 0,005-0,040 %	Sauerstoffhaltiges Kupfer mit einer elektrischen Leitfähigkeit von mind. 57,0 m/Ω mm <sup>2</sup> , jedoch ohne Anforderungen an Schweiß- und Hartlötbarkeit.
SF-Cu	2.0090	8,9	Cu ≥ 99,90 % P = 0,015-0,0404	Ohne Anforderung an elektrische Leitfähigkeit jedoch mit sehr guter Schweiß- und Hartlötbarkeit sowie Wasserstoffbeständigkeit, Rohrleitungen, Apparatebau, Bauwesen.
SECu	2.0090	8,9	Cu ≥ 99,90 % P = 0,003 %	Hohe elektrische Leitfähigkeit mit hohen Anforderungen an Umformbarkeit. Gut schweiß- und hartlötbar. Für Elektronik, auch Plattierwerkstoff

### Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) DIN 17 663

Güte	Wst-Nr.	Dichte ca.	Legierungsbestandteile	Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung
Cu Ni 12 Zn 24 (Ns 6512)	2.0730	8,7	Cu 63,0-66,0 % Ni 11,0-13,0 % Zn Rest	Gut kalt umformbar. Tiefziehteile, kunstgewerbliche Gegenstände, Bauwesen, Innenarchitektur, Federn.
Cu Ni 18 Zn 20 (Ns 6218)	2.0740	8,7	Cu 60,0-63,0 % Ni 17,0-19,0 % Zn Rest	Wie Cu Ni 12 Zn 24, jedoch anlaufbeständiger. Bevorzugt für Federn

Weitere Legierungen auf Anfrage.